

## Scheda multistrato, 26L HDI PCB, FR-4

### Descrizione del prodotto:

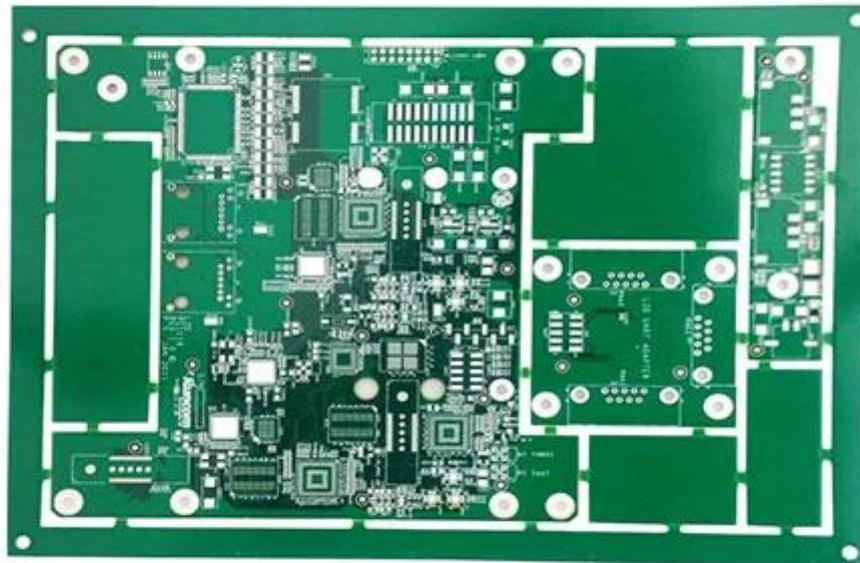
Luogo d'origine	Guangdong, Cina (continente)	Marchio	O-leader
Materiale di base	NPG-150N	Spessore di rame	1 oncia
Min. Dimensione del buco	0,2 millimetri	Min. Larghezza della linea	2.35mil
Finitura superficiale applicabile a	immersione oro	Min. Interlinea	3mil
certificati	Controllo del settore	personaggio	Controllo industriale
peso	ISO9001, UL, RoHS, SGS	Q / CTN	10PCS-100PCS
Numero di modello	0,01 kg -5 kg	MOQ	10 pezzi
colore	produttore pcba assemblaggio pcb banca di potere	Spessore della tavola	0.1-5mm
tipo design	verde	prezzo	\$ 0,1- \$ 10
	richieste del cliente	taglia	0.01m3-10m3

### Imballaggio & Consegna

dettagli sul confezionamento	16 anni produttore professionale di schede clienti OEM
Dettaglio di consegna	7-12days

### Descrizione del prodotto

articolo	2017		2018 ~ 2020		2021 ~ 2023	
	Volume	Campione	Volume	Campione	Volume	Campione
Conteggio dei livelli	32	42	38	44	42	48
Linea / spazio min (µm)	50/50	40/45	40/45	40/40	35/40	35/35
Foro minimo diametro (mm)	0.15	0.10	0.15	0.10	0.15	0.10
Proporzioni di PTH	14: 1	16: 1	16: 1	18: 1	18: 1	20: 1
N + C + N	4 + C + 4	5 + C + 5	5 + C + 5	6 + C + 6	5 + C + 5	6 + C + 6
Qualsiasi interconnessione di livello	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6
Riempimento del piatto via	SÌ	-	SÌ	-	SÌ	-
Min. spessore del nucleo (escluso il rame) (µm)	50	40	40	trenta	40	trenta
Min. Diametro laser drill (µm)	75	65	65	50	50	40
Via su sepolto buco / impilato via	SÌ	-	SÌ	-	SÌ	-
Materiale	FR4, Megtron, Nelco, Rogers, rame pesante, ecc.					
PCB condensatore incorporato	SÌ	-	SÌ	-	SÌ	-
Processo di superficie	HASL senza piombo, ENIG, OSP, argento con immersione, stagno di immersione, Flash di oro, rivestimento a dita dorate, rivestimento in oro massiccio selettivo, Maschera di sfaldatura a saldare, carbonio inK					



[www.o-leading.com](http://www.o-leading.com)

[Pc HDI Circuito stampato](#)